

株式会社フジミインコーポレーテッド 株主通信

# FUJIMI TODAY

2016.4.1～2016.9.30

vol.

# 43

2016年12月発行

特集

## 新中長期経営計画 トップインタビュー

技術を磨き、心をつなぐ

証券コード 5384

# FUJIMI



お客様目線の実践  
革新への挑戦  
新規事業・新規用途開拓の強化



# 技術を磨き、心をつなぐ

私たちの「磨く技術」は半導体をはじめとした  
さまざまな産業で活かされています。

フジミはお客様にあらゆる製品を  
磨いていただくことで、

人々が快適に暮らせる未来の創造に  
貢献します。

代表取締役社長

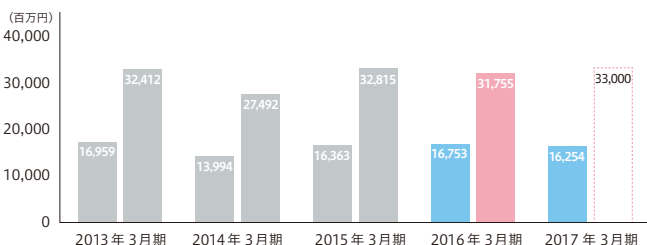
関 敬史



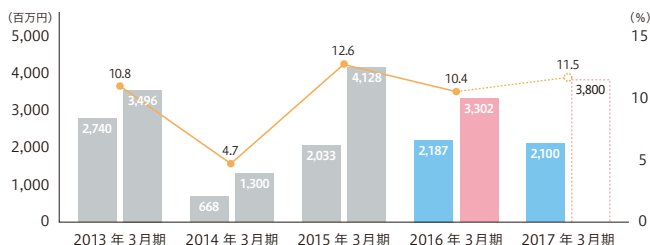
## 連結決算ハイライト

■ 上期 ■ 通期 ● 通期 ※2017年3月期通期は予想値

### ■ 売上高



### ■ 営業利益・営業利益率 折れ線グラフ: 営業利益率 (右軸)



# 株主の皆様へ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

## 》 上期を振り返って

当社グループを取り巻く環境は先進国では米国経済は緩やかな景気回復基調が続き、日本・欧州経済は力強さを欠くものの景気の底堅さがみられましたが、新興国では中国の景気減速が継続し、金融市場においては急速な円高が進むなど、世界経済の先行きへの不透明感が依然として残る状況でありました。

また、世界半導体市場は、春先より緩やかな回復基調を示しており、8月には世界半導体売上高が1年2ヶ月振りに前年実績を上回るなど、回復の動きが見られました。

こうした状況下、当社グループでは一丸となって売上拡大とコスト削減に努めましたが、円高の影響が強く、2017年3月期第2四半期連結累計期間の業績は、売上高16,254百万円(前年同期比3.0%減)、営業利益2,100百万円(前年同期比4.0%減)、経常利益2,171百万円(前年同期比11.1%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益1,710百万円(前年同期比1.7%減)となりました。

上期のトピックスとしましては、昨年11月に設立しましたCVC

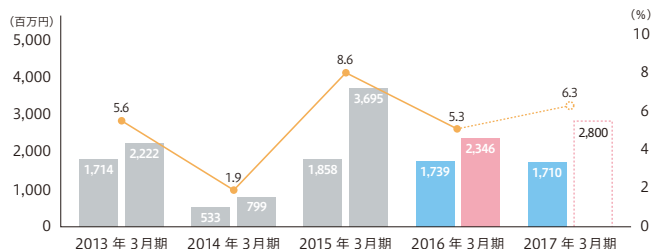
(コーポレート・ベンチャー・キャピタル)ファンドにおいて、ベンチャー企業への投資を6月末に開始しました。当社コア技術とのシナジーを創出し、事業のさらなる拡大と新規事業の機会探索に繋げてまいります。また、8月には愛知県で今年度から始まる「知の拠点あいち重点研究プロジェクト(II期)」における「モノづくりを支える先進材料・加工技術開発プロジェクト」に研究テーマが採択されました。当社は事業化リーダーとして、「革新的金型製造技術の開発とその産業応用」を担当し、積層造型技術を駆使した革新的かつ高品位な金型の開発および実用化を目指して、超硬・高強度材料を使用した粉末積層造型技術開発に参画いたします。

## 》 新中長期経営計画策定

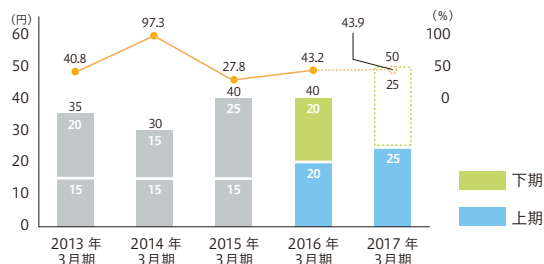
当社は2009年6月に策定した2018年3月期を最終年度とする中長期経営計画を見直し、2022年3月期を最終年度とする新たな6カ年計画を策定しました。詳細につきましては、次ページ以降の「新中長期経営計画」でご説明いたします。

皆様のご厚情に感謝するとともに、これまでと変わらぬご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

■ 親会社株主に帰属する当期純利益・ROE 折れ線グラフ: ROE(右軸)



■ 配当金・連結配当性向 折れ線グラフ: 連結配当性向(右軸)



特集

# 新中長期経営計画 トップインタビュー



## この約10年を振り返っていかがでしょうか？

始めに、現在も進行中の中長期経営計画の中にあります、「品質保証力の強化」を一つの例としてご説明いたします。当社は常にお客様の最先端技術にお応えするべく製品開発を行ってきました。しかし、ご要求に100%応える製品を提供できていなかったことがありました。例えば、当社製品をお客様へ納品後、使用過程で、使い勝手が良くない、製品性能が不十分というご意見を賜ったことがありました。

原因の一つに、開発した試作品を製造へ量産移管する際の工程管理に課題があることが分かり、2011年に開発と製造を連携させる組織としてプロダクトサポート室を設置しました。プロダクトサポート室を開発・製造と関連付けることで社内連携が強化され、製造移管を円滑に進

めることが可能になりました。その他、開発品をお客様へ納品した後、新たにいただいたご意見にもプロダクトサポート室が中心となって対応をすることで、お客様からの当社製品に対する不満は減少し、顧客満足度調査の評価も、ここ5年から10年の間に着実に改善されてきております。

次に「ものづくり力向上」に関してご説明いたします。具体的には、製造部門で発生する問題を極小化していくために、現場の5S活動\*を推進しております。5S活動では拠点毎に3年～5年のロードマップを作成し、一つずつ定着させました。ここでは劇的な改善が見えました。まずは現場の整理整頓が始まり、3年を経ず、工場の動線に対する意見が出るようになりました。お客様が監査や見学に来られると、「整理整頓されている」「5Sが行き届いている」「現場の挨拶がすばらしい」とお褒めいただくことが増え、

\*5S活動 5Sとは「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「しつけ」の頭文字のSをとったもの。組織を上げて取り組む活動。

製造現場の大きなモチベーションとなり自発的な取り組みに変わっていると思います。

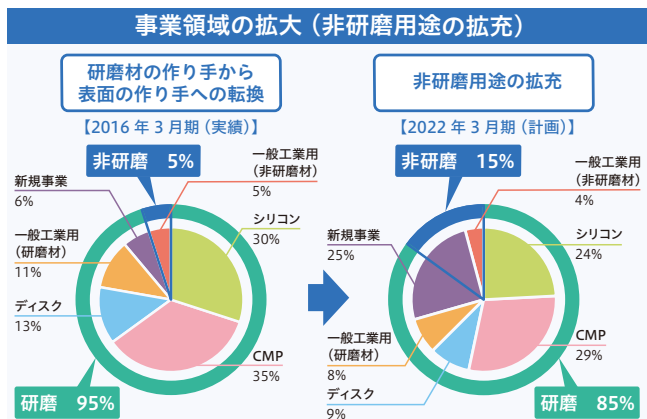
他には「PDCA\*展開力の強化」を推進し、営業、開発、製造のそれぞれがお客様目線で活動する意識がさらに高まりました。これらのアクションプランが、新たな中長期経営計画を策定する上で基盤になっていると感じております。

## 今回の新たな中長期経営計画の狙いは？

詳しくは後ほど述べさせていただきますが、ここでは概要を3つお話いたします。

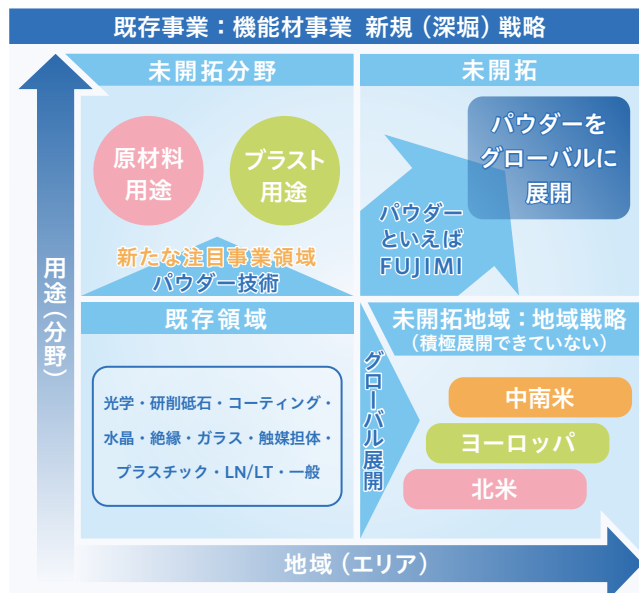
1つ目は、事業領域の拡大です。私たちは、お客様から「研磨材と言えばフジミ」という印象を持たれており、同時に私たち自身も研磨材メーカーとしての意識を持って活動しておりました。一方で、当社の企業ビジョンの中では、研磨という言葉ではなく、「パウダー&サーフェス分野」を掲げております。これは、私たちは研磨以外の分野、例えばパウダー（粉）やサーフェス（表面）分野において、事業領域を拡大していきたいという意味です。

2つ目は、プロセス重視の考え方です。売上や利益の目



標は必要ですが、一方で当社は目標に至る道筋や目標に対して何を行ったかも重要であると考えております。このプロセスを重視することにより、結果として数字はついてくるものと考えております。

3つ目は、従業員のモチベーション向上です。当社の企業文化ビジョンに「強く、やさしく、面白い会社を目指します」とあります。従業員が仕事の面白みをもっと感じられるよう新たな中長期経営計画には、「私たちは一人ひとりの前向きなアイデアとチャレンジを応援します」を中長期企業ビジョンとして掲げることとしました。従業員のアイデアを尊重、チャレンジをサポートし、従業員が働きがいを持って仕事に打ち込める、そして安心して仕事に取り組める環境づくりを、全社一丸となって取り組んでまいります。今後は、各本部で施策として取り組み、新たな仕掛けを構築していきたいと考えております。



\*PDCA 事業活動における生産管理や品質管理などの管理業務を円滑に進める手法のひとつ。Plan (計画)→Do (実行)→Check (評価)→Action (改善)の4つのステップを繰り返すことで、業務を継続的に改善すること。

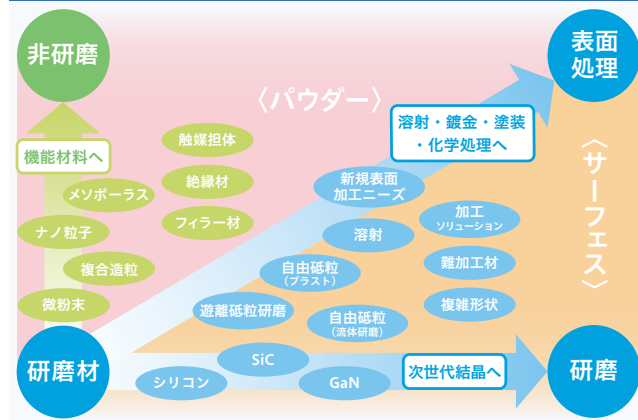
私たちは研磨材メーカーから「パウダー&サーフェスカンパニー」へ転換を進め、売上構成については非半導体向け売上比率をさらに高めてまいります。

## 研磨材メーカーから「パウダー&サーフェスカンパニー」への転換について

当社は、研磨材メーカーとしてスタートしましたが、事業を拡大する一つの流れの中で、昭和30年代には研磨材ではない粉の製品、具体的には絶縁材向けの粉を製品化しました。現在も種類は異なりますが、その製造は続けております。ただ、半導体業界の成長に伴い、リソースを半導体に集中してきた結果、研磨材をメインに製品展開してきました。しかし、今後も研磨材にリソースを集中し続けていては、さらなる成長は難しいと考え、視点を変えてみることにしました。

研磨とは、平らな表面や傷のない表面など、そこに目的の表面を作ることを意味しています。目的の表面を作るには、お客様のニーズに合わせて研磨材を提供するだけでなく、研磨方法などのソリューションを提供するこ

### 研磨材メーカーから「パウダー&サーフェスカンパニー」へ



とも必要になります。当社はソリューションの提供を含め、お客様があらゆる材質や形状の新しい表面を創成する「表面創成」を取組み領域と捉え、研磨材の提供だけではなく、その他の消耗材や装置などの領域まで広げることを考えております。

次に、2000年より、研磨材とは異なるものとして、メタルとセラミックの混合粉を高熱で溶かしながら、スプレーコーティングする「溶射材」の事業を行っております。溶射材事業も表面を皮膜する点では、「サーフェス(表面)」を作ることであり、事業領域を皮膜、コーティングへ広げています。さらに、私たちは「パウダー(粉)」の製造加工技術を持っています。それは、事業領域がもはや研磨に止まらないということです。極端に言えば「化粧品」も「パウダー(粉)」になります。このような可能性の広がりを見据えて私たちは「パウダー&サーフェスカンパニー」と掲げています。

また、最近新聞記事などでよく目にするナノ粒子に目を向けますと、この領域では、粉を添加することで新しい機能をもたらす製品や製造技術が世の中に多くあります。そして私たちが扱っているセラミックス系の製品やその製造技術は、そういったものの代表格として捉えられており、私たちのこれまで積み重ねてきた技術を、この領域でもさらに応用発展させられる可能性は高いと考えております。

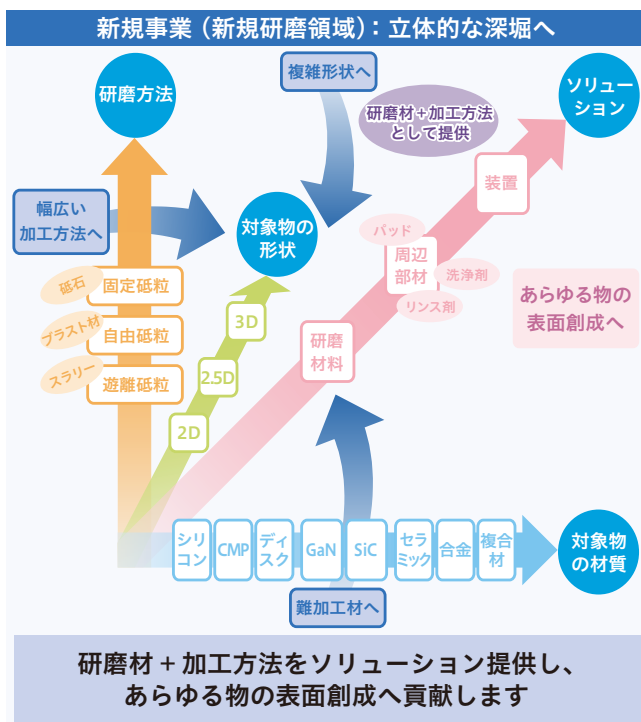
## 海外展開について

当社は世界7カ国(日本、米国、台湾、マレーシア、ドイツ、中国、韓国)に拠点があります。その拠点を有効活用し、現在当社製品を供給できていない未開拓地域へ積極的

に展開していきたいと考えております。今後、当社のさらなる成長を見据えた時、事業領域の拡大と共に既存事業領域の地理的な拡大にも十分な可能性があると考えております。

## 多様化・複雑化するお客様のご要望への対応について

お客様が研磨で目的の表面を実現するためには、研磨材だけではなく、研磨装置、研磨パッド(布)が必要となります。研磨材以外のものはこれまでお客様がご用意され、私たちは研磨材に特化してきました。ところが、お客様のご要望が多様化・複雑化し、研磨材のみならず、その他の消耗材を含め研磨プロセス全体の提案を求め



られ、ソリューションを提供することが多くなりました。さらにこれまではお客様で行っていた分析や研究も、コストやスピードの面から、私たちが行い、お客様へ提供することも増えております。私たちの研磨材ビジネスを成功させるためにそのようなサービスも提供してまいります。

また、球形状や立体形状、さらに複雑な形状の表面創成のご要望にお応えするには、トータルでソリューションを提供しなければ解決できないということもあります。お客様のご要望、作業環境、加工材質などあらゆる条件が多様化・複雑化する中で、私たちはこれからも研磨を通してさらに多方面からのお客様のニーズにお応えしていきます。

## 新規事業について

私たちはスマートフォンや自動車などの最終製品を開発しているわけではありません。そのため、例えば10年先のメガトレンドを予測し、そこから何か新しい製品を開発していける立場にはありません。その中のある部位や部品の製造工程における多くの階層のうちの一部に関わることとなります。そうなりますとその領域が、例えば医療なのかエネルギーなのかなど、どこの領域なのか見定めることは難しいため、さまざまな領域のお客様のご要望が、私たちのビジネスチャンスに繋がると考えております。

そのためには、全方位的に動かなければならないということですが、その活動をいかに効率的に行っていくのかというリソースのマネジメントとさまざまな領域のお客様と自分たちをいかにつないでいくかということが重要になってくると考えております。

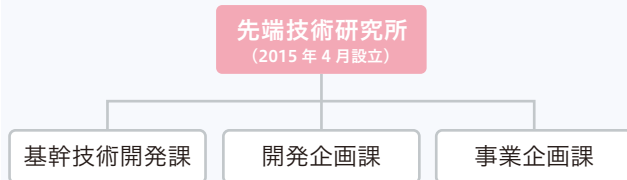
ここ数年積極的に行っている展示会への出展には、そのような背景があります。これまでは半導体の限られた領域でしたが、学会や大学、公的な研究機関など、広く情報のネットワークをつくり、新たな情報の探索を行います。そして、3年先、5年先に向けた研究状況などを把握することにより、ビジネスチャンスもより見えてくるのではないかと考えております。

また、学会への参加は学術的な視点だけではなく、企業とのネットワークも新たに構築できます。このような5年先、10年先を見据えた新規事業機会の探索活動については、昨年設立しました先端技術研究所を核に進めております。一方、5年以内の将来テーマについては、事業本部との連携を図りながら対応しております。

次に、先端技術研究所について改めてご説明いたします。設立の目的は2点あります。

1点目は、既存事業のさらなる基盤強化のために、当社のコア技術（「ろ過・分級・精製」「パウダー」「ケミカル」）について、先端技術研究所を通じて理解を深め、事業本

### 先端技術研究所（パウダー＆サーフェス領域）：組織と役割



### ミッション = 新規事業の創出

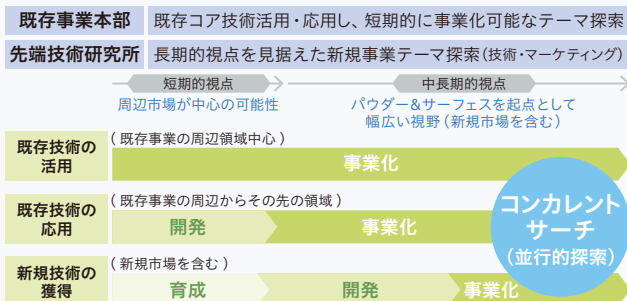
- ・ 基盤技術の深耕、拡張
- ・ 中長期的視野での新規分野のマーケティング
- ・ ベンチャー投資も視野に入れたアライアンス、M&Aの検討

部および機能本部の連携を深めることです。2011年に事業本部制を導入し、開発と営業を一体化しました。その結果、お客様へ提供できるサービスや製品のスピードが高まりました。一方で、事業本部間で技術や情報を融通しあうことがスムーズにできなくなっていたことが、設立の背景にありました。

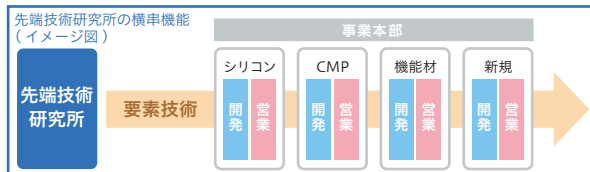
先端技術研究所では、事業本部間の共通する要素技術や新たな事業機会に対して事業本部をコーディネートし、場合によっては協働して動くなど、方向性が明確になるまで中心となって対応します。そして技術を習得して、体制などが整って事業が軌道に乗れば、事業本部に引き渡していくという進め方となります。

2点目は、5年以上先の将来を見据えた活動です。先ほども触れました、展示会や学会、大学、公的な研究機関などを広く情報のネットワークで網羅し、新しい技術や新し

### 先端技術研究所：新規事業のコンカレント探索体制



### ◎技術の統括（事業本部間の横串機能）





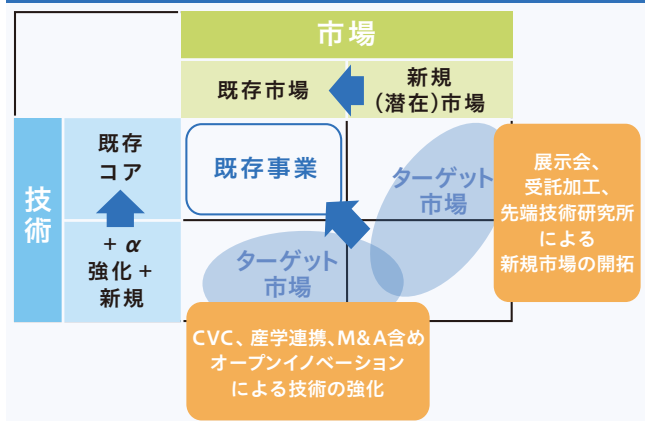
いビジネスを探索し事業化していくために、さまざまな活動を展開しております。

さらに、現在はフジミの技術に直接関係なくても、将来の事業として展開できる可能性のある技術を取り込むために、CVC\*(コーポレート・ベンチャー・キャピタル)にも取り組んでまいります。現状の事業に関係するものばかりに目を向けていると限定的になってしまう恐れがあるので、CVCを通して分散投資、小口投資を行い、そこから出てくる芽を幅広く見ていくことが必要と考えております。また、先端技術研究所にはM&A\*機能を持たせております。これまで私たちは目に見える形でM&Aをやってきたわけではありません。しかし、今後は他社との事業提携も大きな戦略の柱に見据えていかなければならないと考えており、この5年でその施策を推進してまいります。

## 事業継続計画(BCP\*)について

当社では日本、米国、台湾、マレーシアで、共通の設備と技術を保有しています。そのためBCPへの対応も可能

### 新規事業(パウダー&サーフェス領域):新規事業機会の探索・育成



\*CVC コーポレート・ベンチャー・キャピタルの略。自社の戦略目的のために、事業会社によるベンチャー企業への投資活動のこと。

\*M&A Merger(合併)とAcquisition(買収)の略。2つ以上の会社が1つになったり、ある会社が他の会社を買収すること。

\*BCP Business Continuity Planの略。緊急時における事業継続のための方法や手段を取り決めておく計画のこと。

であると考えております。

## 今回の中長期経営計画の数値目標について

売上目標を2022年3月期に600億円とします。その中で新規事業向けは6%から25%以上に、非半導体向けは35%から45%以上に、非研磨向けは5%から15%以上に、それぞれ引き上げてまいります。営業利益率については15%以上を目指してまいります。

また、2019年3月期を目途に連結配当性向を50%まで引き上げてまいります。今後ともご支援を賜りますようお願い申し上げます。

### 新中長期経営計画(中長期企業ビジョン/定量目標)

#### ◎中長期企業ビジョン

私たちは一人ひとりの前向きなアイデアとチャレンジを応援します

#### ◎定量目標

	2016年3月期 実績	2017年3月期 予想	2022年3月期 計画
売上高	317億円	330億円	600億円
新規事業売上構成	6%	7%	25%以上
非半導体売上構成	35%	35%	45%以上
非研磨分野売上構成	5%	7%	15%以上
営業利益率	10.4%	11.5%	15%以上
ROE	5.3%	6.3%	10%以上
ROA	4.6%	5.5%	8%以上

#### ◎株主還元策

連結配当性向を将来的に50%に引き上げ(2019年3月期を目処に)

# 用途別の動き

## シリコンウェハー用

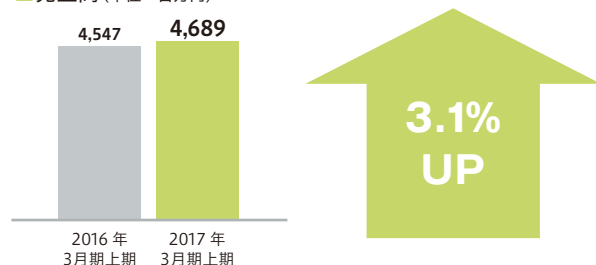
28.8%

売上構成比

シリコンウェハー向け製品につきましては、ラッピング材の売上高は1,600百万円(前年同期比0.9%減)、ポリシング材の売上高は一部の製品で販売が増加したことにより、3,088百万円(前年同期比5.3%増)となりました。

パソコンを中心に、電子・IT関連機器の心臓部に使用されている半導体部品の土台がシリコンウェハー(半導体基板)です。このウェハーをいかに高精度に鏡面研磨できるかが、エレクトロニクス製品の性能を大きく左右します。当社グループの主力となるシリコンウェハー用製品では、お客様の期待に応える製品開発をタイムリーに行い、品質の高い新製品をいち早く市場に投入してまいります。

■売上高(単位:百万円)



ラッピング材の主力製品 FO



ポリシング材の主力製品 GLANZOX

## CMP用

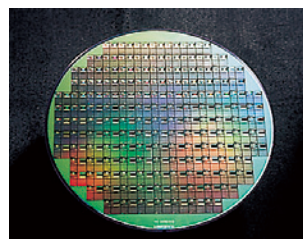
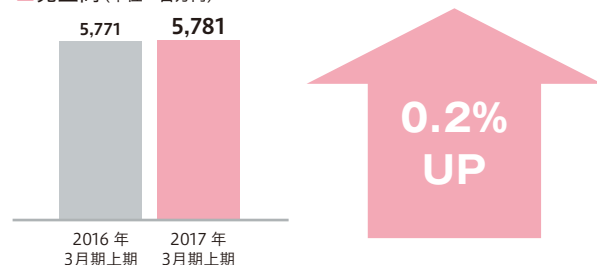
35.6%

売上構成比

CMP向け製品につきましては、円高の影響もありましたが、メモリデバイス向け製品の販売が増加したことから、売上高は5,781百万円(前年同期比0.2%増)となりました。

エレクトロニクス製品の小型化とともに高機能化・高性能化が急速に進み、半導体チップはますます高集積化・微細化が求められています。CMP(化学的機械的平坦化)用製品群は、長年にわたるシリコンウェハー用ファイナルポリシング材のノウハウを応用し開発され、多層配線技術に対応しています。お客様のロードマップにあった迅速な開発品の提供や技術サービスを核に、マーケットシェアの拡大を目指してまいります。

■売上高(単位:百万円)



デバイスウェハー



CMP用の主力製品 PLANERLITE

## ハードディスク用

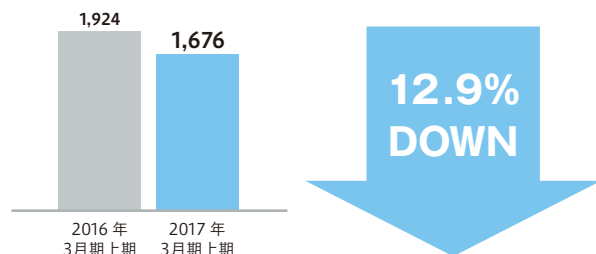
10.3%

売上構成比

ハードディスク向け製品につきましては、円高及びハードディスクドライブ業界の生産調整の影響を受け、売上高は1,676百万円（前年同期比12.9%減）となりました。

ハードディスクは、パソコンの記憶装置、DVDレコーダー、カーナビなどにも搭載されており、最近ではクラウド向けの用途が拡大しています。デジタル家電の高機能化に伴い、プログラムやデータの高速読み出しが可能な小型・大容量のハードディスクの需要が高まり、シリコンウェーハー同等の面精度が要求されています。各業界のニーズをいち早くキャッチし、開発期間の短縮化によりお客様の要求にあった新製品をタイムリーに提供してまいります。

■売上高（単位：百万円）



車載カーナビ(イメージ)



ハードディスク用の主力製品 DISKRITE

## 一般工業用・その他

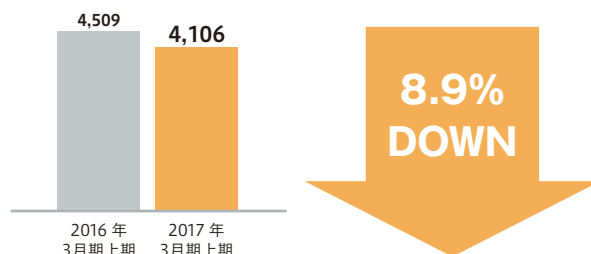
25.3%

売上構成比

非半導体関連の一般工業用研磨材につきましては、最終製品の生産調整により、売上高は2,849百万円（前年同期比14.6%減）となりました。その他につきましては、1,257百万円（前年同期比7.2%増）となりました。

LED・ディスプレイ・パワーエレクトロニクス用部品の表面加工分野やパウダー技術を活かし、応用分野への研磨・研削材の開発にも積極的に取り組んでいます。最近では、新規用途の一般工業研磨材にも注力しており、トータルソリューションの提供によりお客様の信頼を得ています。溶射材は鉄鋼、航空機および半導体等さまざまな業界の溶射用途向けに、主にサーメット溶射材とセラミック溶射材を提供しています。

■売上高（単位：百万円）



サファイア基板用の主力製品 COMPOL



溶射材の主力製品 SURPREX

## 連結財務諸表

連結損益計算書	前第2四半期 連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)	当第2四半期 連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日)
	売上高	16,753
売上原価	9,870	9,595
売上総利益	6,883	6,658
販売費及び一般管理費	4,695	4,557
営業利益	2,187	2,100
営業外収益		
受取利息	15	11
その他	247	107
営業外収益合計	262	118
営業外費用	9	47
経常利益	2,441	2,171
特別損失	-	18
税金等調整前四半期純利益	2,441	2,152
法人税、住民税及び事業税	419	527
法人税等調整額	281	△84
四半期純利益	1,739	1,710
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,739	1,710

(単位：百万円)

### 売上高

世界半導体市場は、春先より緩やかに回復基調を示しており、8月には世界半導体売上高が1年2ヶ月振りに前年実績を上回るなど、回復の動きが見られました。しかしながら、円高の影響や非半導体関連の一般工業用研磨材で最終製品の生産調整により売上高は前年同期比3.0%減の16,254百万円となりました。

### 営業利益

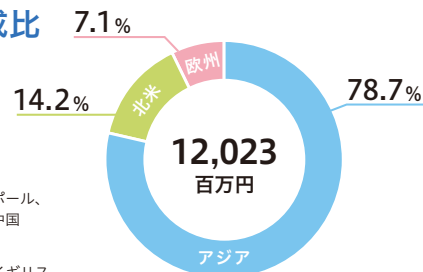
売上の減少に伴い、前年同期比4.0%減の2,100百万円となりました。

### 親会社株主に帰属する四半期純利益

前期比1.7%減の1,710百万円となりました。

### 海外売上高構成比

(第2四半期連結累計期間)



※各区分に属する地域の  
主な内訳は次のとおりです。

- アジア：台湾、タイ、シンガポール、マレーシア、韓国、中国
- 北米：米国、カナダ
- 欧州：ドイツ、イタリア、イギリス

### 海外売上高

海外売上高	前第2四半期 連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)	当第2四半期 連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日)
	海外売上高	12,741
連結売上高	16,753	16,254
連結売上高に占める割合	76.1%	74.0%

(単位：百万円)

## 連結貸借対照表

前第2四半期  
連結会計期間  
(平成27年9月30日)

当第2四半期  
連結会計期間  
(平成28年9月30日)

資産の部		
流動資産		
現金及び預金	17,750	22,273
受取手形及び売掛金	6,534	7,252
有価証券	6,704	500
たな卸資産	5,728	5,197
繰延税金資産	510	478
その他	238	247
貸倒引当金	△10	△12
流動資産合計	37,457	35,937
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	7,608	7,060
その他(純額)	6,106	5,982
有形固定資産合計	13,714	13,042
無形固定資産		
677	594	
投資その他の資産		
投資有価証券	216	559
繰延税金資産	83	177
その他	502	109
貸倒引当金	△124	△9
投資その他の資産合計	678	838
固定資産合計	15,070	14,475
資産合計	52,528	50,413

(単位：百万円)

前第2四半期  
連結会計期間  
(平成27年9月30日)

当第2四半期  
連結会計期間  
(平成28年9月30日)

負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,990	3,013
未払法人税等	324	484
賞与引当金	861	872
役員賞与引当金	40	38
その他	2,749	1,516
流動負債合計	6,966	5,925
固定負債		
繰延税金負債	20	6
退職給付に係る負債	328	545
その他	20	38
固定負債合計	369	590
負債合計	7,336	6,515
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,753	4,753
資本剰余金	5,038	5,038
利益剰余金	39,942	39,989
自己株式	△5,379	△5,108
株主資本合計	44,354	44,673
その他の包括利益累計額	836	△775
純資産合計	45,191	43,897
負債純資産合計	52,528	50,413

(単位：百万円)

## 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果得られた資金は前年同期に比べて1,049百万円増加し、2,961百万円の収入となりました。これは主に、売上債権の増加による資金の減少があったものの、仕入債務が減少から増加に転じたこと及び法人税等の支払額が減少したことによる資金の増加があったことによるものであります。

## 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果得られた資金は、638百万円となり、前年同期と比べ1,041百万円の減少となりました。これは主に、有価証券の取得による支出が減少したものの、定期預金の払戻による収入が減少したことによるものであります。

## 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果得られた資金は9百万円となりました(前年同期は635百万円の支出)。これは主に自己株式取得のための預託金の払戻による収入があったことによるものであります。

## 配当金および連結配当性向の推移

当社は、株主に対する適正な利益還元を行うことを経営の重要課題と認識し、配当につきましては、将来的に50%以上の連結配当性向を目標として、業績に応じた積極的な株主還元を実施するとともに安定配当の継続にも留意し配当を行うことを基本方針としております。このような方針のもと、当期末配当金は、1株につき25円とし、年間配当金は、1株につき50円とする予定です。

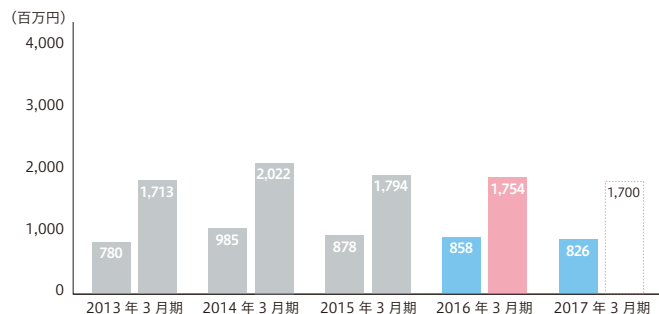
## 連結キャッシュ・フロー計算書

	前第2四半期 連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)	当第2四半期 連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日)
● 営業活動によるキャッシュ・フロー	1,912	2,961
● 投資活動によるキャッシュ・フロー	1,679	638
● 財務活動によるキャッシュ・フロー	△635	9
現金及び現金同等物に係る換算差額	△356	△656
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	2,599	2,952
現金及び現金同等物の期首残高	18,426	19,820
現金及び現金同等物の四半期末残高	21,025	22,773

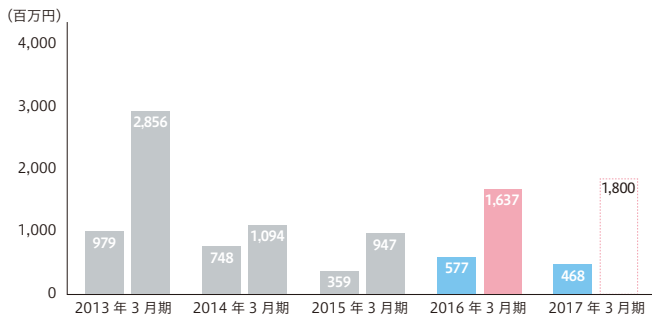
(単位: 百万円)

■ 上期 ■ 通期 ● 通期 ※2017年3月期通期は予想値

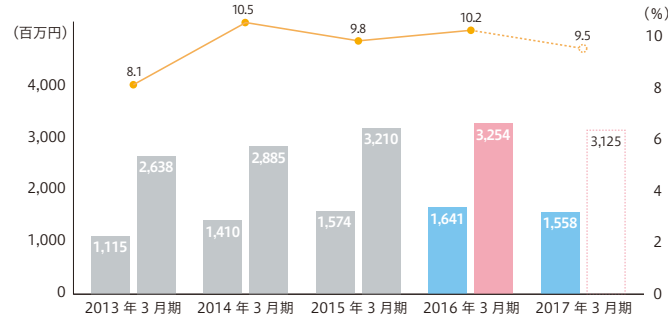
## 減価償却費



## 設備投資額



## 研究開発費・売上高比



## 株式情報 2016年9月30日現在

### 株式の状況

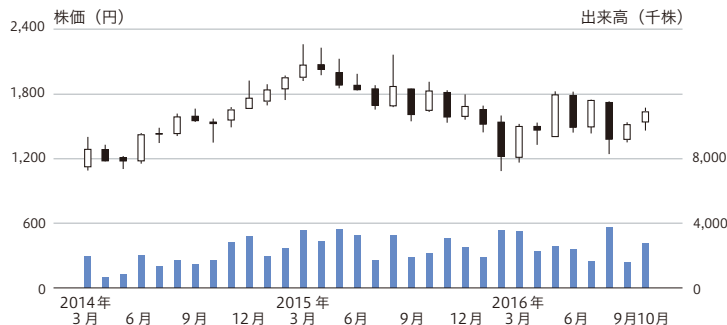
株式数 発行可能株式数	120,000 千株
発行済株式総数	28,699 千株
株主数	7,355 名

### 大株主 (株主名) 持株数 (千株) 持株比率 (%)

株式会社フジインコーポレーテッド	4,051	14.1
有限会社コマ	3,743	13.0
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	1,287	4.4
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	1,156	4.0
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE-HCR00	973	3.3
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	728	2.5
越山 勇	717	2.4
株式会社りそな銀行	691	2.4
日本生命保険相互会社	639	2.2
フジミ取引先持株会	604	2.1

※持株数は千株未満を切り捨て、持株比率は小数点第2以下を切り捨てしています。

## 株価および出来高の推移

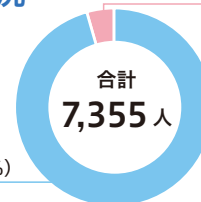


## 株主分布状況

2016年9月30日現在

7,047 人 (95.8%)

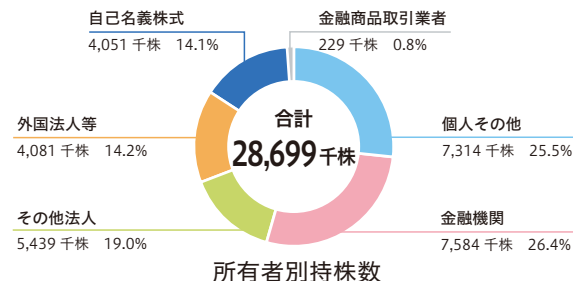
個人その他



308 人 (4.2%)

内訳  
 金融機関 36 人 (0.5%)  
 金融商品取引業者 34 人 (0.5%)  
 その他法人 94 人 (1.3%)  
 外国法人等 143 人 (1.9%)  
 自己名義株式 1 人 (0.0%)

所有者別株主数



所有者別持株数

## 役員

2016年  
9月30日現在

代表取締役社長	関 敬史
常務取締役	伊藤 広一
取締役	鈴木 彰
取締役	大脇 寿樹
取締役	鈴木 勝弘
取締役	川下 政美*
常勤監査役	松島 伸男
常勤監査役	藤川 佳明
監査役	高橋 正彦**
監査役	岡野 勝**

(\*印は社外取締役) (\*\*印は社外監査役)

## 会社データ 2016年9月30日現在

商号	株式会社フジインコーポレーテッド
証券コード	5384
本社所在地	愛知県清須市西枇杷島町地領 2-1-1 TEL. 052-503-8181 (代表)
設立年月日	1953年 (昭和28年) 3月20日
資本金	4,753 百万円
代表者	代表取締役社長 関 敬史
従業員	829 名 (個別 574 名)

# 株主メモ

2016年9月30日現在

決算日	3月31日
基準日	3月31日
単元株式数	100株
公告方法	電子公告 ( <a href="http://www.fujimiinc.co.jp">http://www.fujimiinc.co.jp</a> ) ただし、事故その他やむを得ない事情によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載することといたします。
株主名簿管理人	〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱場所	〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
郵便物送付先 および照会先	〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-232-711 (通話無料)

## 各種手続のお申出先

- 支払期間経過後の配当金のお支払いについては、株主名簿管理人にお申出ください。
- 住所変更、単元未満株式の買取、配当金受取方法の指定等  
証券会社をご利用の株主様は、お取引の証券会社へお申出ください。  
証券会社をご利用でない株主様は、特別口座の口座管理機関である日本証券代行株式会社へお申出ください。

### 【ご注意】

特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、日本証券代行が口座管理機関となっておりますので、下記特別口座の口座管理人に、お問合わせください。

特別口座管理機関 連絡先	日本証券代行株式会社 〒168-8620 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 日本証券代行株式会社 代理人部 電話 0120-707-843 (通話無料)
-----------------	---

## 株式会社フジミインコーポレーテッド

お問い合わせ先：財務部経営企画課  
TEL：052-503-8181 (代表)  
URL：<http://www.fujimiinc.co.jp>

Copyright (C) 2016 Fujimi Incorporated. All rights reserved.



この印刷物は、環境負荷低減のため古紙パルプを80%使用した環境対応紙と、植物油を使用し、VOCの排出を抑えた環境対応型リサイクルインキ「ベジタブルインキ」を使用しています。